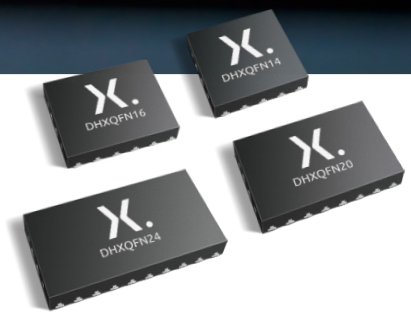
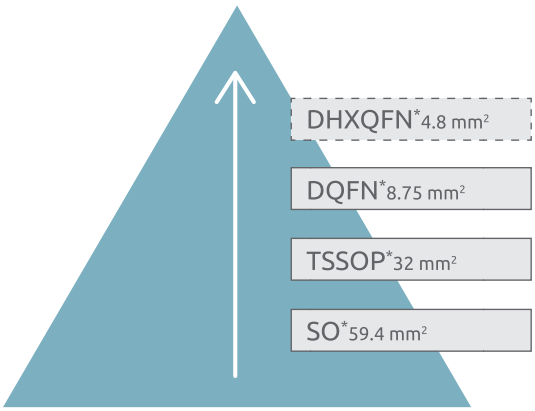
Nexperia宣布全面推出DHXQFN封装

业界最小巧纤薄的14、16、20和24引脚封装，提供标准逻辑功能

微型化是半导体行业的持续发展趋势，Nexperia推出的DHXQFN封装进一步推动了标准逻辑产品系列的这一趋势。与业界适用于16引脚器件的DQFN封装相比，它将封装管脚尺寸减小了45%。



标准逻辑封装的微型化

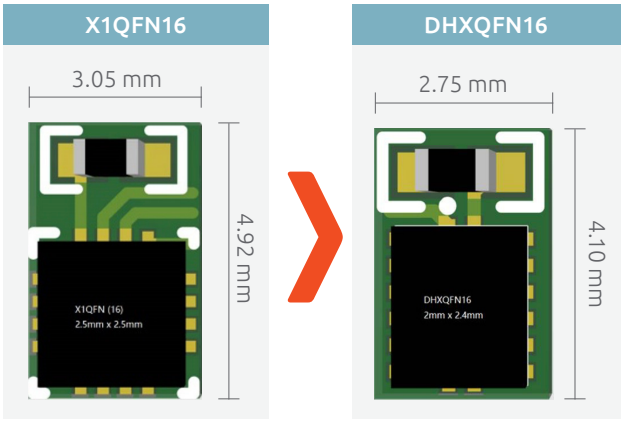


*基于16引脚封装

与类似的竞争产品相比，16引脚DHXQFN封装不仅提供更小的管脚尺寸，而且还节省25%的PCB占用面积。

节省PCB布板空间

此外，小管脚尺寸使器件能够更靠近旁路电容。这对于逻辑器件电路板焊盘空间有限的设计来说会是一个重大优势，并且逻辑器件和电容之间的走线较短，提高了高频应用中的性能。



nexperia

EFFICIENCY WINS.

以前，器件的管脚尺寸非常大，所以很难将大量逻辑功能集成到小尺寸系统中。但是，DHXQFN封装显著缩小了管脚尺寸，因而能够将74HC595移位寄存器等功能集成到手持式、便携式和互联网连接的工业设备中。

封装详细信息：

DHXQFN封装提供14、16、20和24引脚，间距为0.4mm，高度为0.45 mm，以后缀BZ标识。

特性和优势：

- 小巧纤薄的14、16、20和24引脚封装。
- 与竞争产品封装相比，节省多达25%的PCB占用空间。
- 与行业标准DQFN封装相比，节省45%的空间。
- 该封装的管脚尺寸小，而且非常薄，因此非常适合空间受限的应用。
- 由于电源旁路电容C放置更近，因而可在高频率应用中提供更出色的性能。
- 针对制程、产品和封装的控制计划。
- 符合RoHS和“深绿”标准。

引脚	封装	Sot #	后缀	管脚尺寸（宽 x 长 x 高）{mm}	引脚间距{mm}	
14	DHXQFN14	SOT8014	BZ	2.0 x 2.0 x 0.48	0.4	
16	DHXQFN16	SOT8016	BZ	2.0 x 2.4 x 0.48	0.4	
20	DHXQFN20	SOT8020	BZ	2.0 x 3.2 x 0.48	0.4	
24	DHXQFN24	SOT8024	BZ	2.0 x 4.0 x 0.48	0.4	

DHXQFN封装的功能：

DHXQFN产品组合具有行业最常见的功能。其中包括施密特触发器、带输出锁存器的移位寄存器、电平转换收发器、八路缓冲器/线路驱动器、八路总线收发器和8位双供电电平转换收发器。

器件类型	详细信息
74LV14ABZ	十六进制反相施密特触发器
74LVC14ABZ	十六进制反相施密特触发器
74HC595BZ	8位SIPO移位寄存器，带输出锁存器；三态
74AVC4T245BZ	4位双供电电平转换收发器；三态
74LVC244ABZ	八路缓冲器/线路驱动器；三态
74LVC245ABZ	八路总线收发器；三态
74LVC8T245BZ	8位双供电电平转换收发器；三态
74AVC8T245BZ	8位双供电电平转换收发器；三态

© 2021 Nexperia B.V.
保留所有权利。未经版权所有者事先书面同意，禁止复制本文全部或部分内容。本文档中所提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，且被认为是准确可靠的，如有变更，恕不另行通知。对于使用本文档所产生的任何后果，出版方概不承担任何责任。出版内容既不传达也不暗示专利或者其他工业或知识产权下的任何许可。

发布日期：
2021年6月